

TÜV莱茵将举办功能安全及网络安全技术峰会

上海2023年8月9日 /美通社/ --

2023年9月20-21日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团（简称“TÜV莱茵”）将在上海举办“第三届功能安全及网络安全技术峰会”，聚焦汽车与半导体芯片领域，邀请国内外专家共话行业现状及未来趋势，深入探讨功能安全及网络安全法规标准，分享汽车与半导体芯片的技术应用和实践经验。如需报名参会，请[点击此处](#)。



随着技术的不断演进，智能网联汽车渗透率快速提升。然而，智能化、网联化在为汽车产业转型升级带来创新驱动力的同时，也给产业发展带来了前所未有的安全风险。日前，中国工信部、国家标准化管理委员会联合修订发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，将深入推进智能网联汽车标准体系建设，并继续加大在功能安全、网络安全、操作系统等重点领域的标准研制力度，推动中国智能网联汽车产业高质量发展。

在为期两天的峰会上，TÜV莱茵国内外专家们将围绕全球功能安全与网络安全现状及发展趋势、车企应对欧盟GDPR数据法案合规性、人工智能在汽车功能安全领域的应用、半导体芯片功能安全核心技术、车辆数据安全和网络安全、零部件层级网络安全、功能安全管理体系，以及SOTIF标准、Automotive SPICE标准、欧盟(EU)2019/2144、UN R155和R156法规等行业热门话题进行详尽解析。

同时，本次峰会还邀请到来自芯思维、旗芯微、北云科技、汇川联合动力、逸驾智能、地平线、芯驰半导体、联合汽车电子、禾赛科技、芯擎科技的技术专家。他们将从不同角度分享各自在汽车电子与半导体芯片领域的技术应用和实践经验，为产业创新发展献计献策。

TÜV莱茵是最早一批在中国开展网络安全和功能安全业务的国际第三方认证机构，作为核心编委会成员参与了标准制定。凭借丰富的项目经验和对标准的精确理解，TÜV莱茵功能安全及网络安全专家团队可为整车厂、零部件制造商和软件供应商提供一站式解决方案，服务涵盖ISO/SAE 21434、ISO 26262、Automotive SPICE、GDPR、渗透测试等，满足企业“全面安全”的需要。

当前，全球主要发达国家和地区都将智能网联汽车作为未来发展的重要战略方向，持续加快产业布局、制定产业政策和发展规划。多年来，TÜV莱茵为促进业界对话，坚持搭建交流平台，致力携手行业伙伴探索前沿技术和解决方案，建立并完善标准体系，为推动智能网联汽车产业健康有序发展贡献力量。

9月20-21日，“第三届功能安全及网络安全技术峰会”期待您的参与。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/198923.html>